

## Executive Summary

今日主线: **AI算力产业链全面爆发**, 五大核心方向引领新一轮科技浪潮。AI算力基础设施产业链 (★5) 持续高景气, Rubin架构推动硬件升级需求激增, 关联标的MRVL、工业富联等表现强劲; AI光互联/CPO产业链 (★5) 进入量产阶段, 英伟达全面推动硅光+CPO时代, 天孚通信、中际旭创等核心厂商深度受益; AI电子元件与材料升级 (★5) 呈现结构性机会, 国瓷材料、三环集团等高端产品需求激增。光通信、PCB、散热等细分领域均出现显著量价齐升趋势。

边际变化: 端侧**AI**成为全新爆发点, 产业链延伸至消费电子领域。今日最显著的新变化是AI从服务器端向PC、手机、XR等端侧消费电子扩散, 联想集团、传音控股等消费电子厂商迎来新机遇, 标志着AI应用场景从云端向终端全面渗透。同时, AI数据中心供电与储能 (★4) 从幕后走向台前, 西门子联合Fluence推出含储能系统架构, AIDC配储成为新趋势。量子计算产业化 (★3) 也出现重要催化, IBM承诺投资超100亿美元, 产业化进程加速。

关注点: 重点关注技术迭代催化与供需缺口收窄风险。核心催化包括Rubin架构量产进度、CPO技术规模化应用时间节点、以及端侧AI芯片大规模商用; 主要分歧在于AI需求增长速度与供应链产能释放节奏的匹配程度, 需跟踪光芯片、高端PCB等关键环节产能扩张进度; 重点跟踪变量包括北美数据中心Capex投入、AI服务器出货量、以及相关公司Q2业绩指引修正情况。

## 宏观 / 策略

宏观经济与政策 宏观策略 ★★☆☆☆ 2026-06-02 19:49

- 5月规模以上工业增加值增速4.3%
- 新一代信息技术产业PMI达57.6%
- 算力期货研发准备

浙商宏观[中性] 经济修复的亮点与隐忧并存, 新一代信息技术产业表现强劲

上海政策[看多] 加快推出液化天然气期货, 做好算力期货研发准备

△ 分歧: 主要差异在复苏节奏、政策效果以及不同行业分化程度

后续验证: 工业增加值增速 PMI数据变化 政策支持力度 AI产业投资

## 行业 / 主题

AI算力 (4条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-06-02 11:43 ~ 2026-06-03 00:23

AI算力基础设施产业链在Rubin架构推动下迎来全面升级, 连接、供电、散热等环节需求激增。关键数据显示: Blackwell GB300芯片功耗达1400W, 即将量产的Rubin VR200功耗将飙升至2300W, 未来Feynman架构预计提升至4400W; NVL72单机柜消耗44万颗MLCC。各家公司观点存在分歧: 看好方认为连接环节战略地位凸显, Marvell获英伟达战略投资并推出102.4Tbps交换芯片打破博通垄断; 担忧方关注数据中心建设趋缓可能影响燃机需求。相比此前, Ruben架构带来的功耗提升成为新的增长驱动力。后续验证变量包括: 订单落地情况、芯片功耗实际表现、数据中心建设进度、交换芯片出货量。

- Rubin VR200单颗芯片功耗高达1400W
- NVL72单机柜消耗44万颗MLCC
- 2026-2028年全球燃机供需缺口为10、30、50GW
- 服务器电源价值量从5.6万美元上调至7.6万美元

DBDZ[看多] Marvell可能成为下一家万亿美元公司, AI算力分布式演进连接环节战略地位凸显

华西有色[看多] 华为韬定律与Rubin结合, 纳米晶电感解决AI算力最大瓶颈

招商电新[看多] AI数据中心配储成趋势, 中压UPS有望迎来规模应用

天风电新[看多] 思泉新材液冷订单落地, 预计26年净利润3-3.5亿

HF电新[看多] 国瓷材料是MLCC链条上最关键的环节之一

△ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、技术路线选择 (如风冷vs液冷vs储能配置比例)、价格弹性以及国内外需求差异

后续验证: 订单落地情况 芯片功耗实际表现 数据中心建设进度 交换芯片出货量

关联: MRVL · 盛科通信 · 裕太微 · 工业富联 · 潍柴动力 · 思泉新材 · 飞龙股份 · 龙磁科技 · Fluence · 江海股份 · 杰华特 · 芯朋微 · 博通 · NVIDIA · Alphabet

## AI端侧应用与消费电子 ★★★★★ 2026-06-02 08:51

AI从服务器端向PC、手机等端侧消费电子扩散，端侧AI趋势逐步验证。关键数据显示：英伟达RTX Spark芯片验证端侧AI趋势，美股软件股从AI吞噬论转向AI赋能论。各家公司观点存在分歧：看好方认为端侧AI打开新空间；担忧方关注端侧算力限制和应用场景成熟度。相比此前，端侧AI芯片性能和生态逐步完善。后续验证变量包括：端侧AI芯片销量、消费电子AI功能渗透率、软件适配情况、用户接受度。

- RTX Spark提供1 petaflops算力与128GB统一内存
- 戴尔、联想、华硕等将推出搭载RTX Spark的产品
- AI服务器拉动高端MLCC紧缺
- IGV五月单月涨幅约21.2%

华福电子[[看多](#)] AI对MLCC拉动不会只停留在服务器端，将向端侧消费电子扩散

中泰传媒[[看多](#)] Token经济投资机会有望被强化，AI应用投资活跃度提升

浙商计算机[[看多](#)] 从买卡扩产走向算力收租，Token即收入模式确立

国金计算机[[看多](#)] Agent时代到来，Token就是收入

财通软件[[看多](#)] 软件开始用业绩回答AI吞噬论，基础软件回暖明显

△ 分歧: 主要差异在端侧AI普及速度、不同厂商技术路线选择以及AI对不同类型软件影响程度

后续验证: 端侧AI芯片销量 消费电子AI功能渗透率 软件适配情况 用户接受度

关联: 联想集团 · 传音控股 · 宏和科技 · 江丰电子 · MongoDB · Snowflake · Salesforce · ServiceNow · 润达医疗 · 阿里巴巴 · 腾讯 · 智谱AI

## AI散热与热管理技术 ★★★★★☆ 2026-06-02 22:22 ~ 2026-06-03 00:10

AI芯片功耗急剧上升推动散热系统向液冷技术升级，高端散热方案加速导入。关键数据显示：Rubin VR200芯片功耗达2300W，未来Feynman架构预计提升至4400W；思泉新材获阿里液冷订单约20亿，公司份额约50%。各家公司观点一致看好液冷趋势，分歧在于金刚石复合材料渗透速度：部分认为1.5kw以上芯片有望采用金刚石方案，2026H2进入落地阶段；另一部分关注成本下降速度。相比此前，散热技术从风冷向液冷、金刚石方案快速切换。后续验证变量包括：液冷订单落地、金刚石材料价格、散热方案渗透率、芯片功耗实际水平。

- Rubin VR200单颗芯片功耗高达1400W
- 思泉新材获阿里液冷订单50%份额
- Fluence储能系统纳入AI数据中心参考架构
- HW韬定律带来更高散热需求

天风电新[[看多](#)] 思泉新材液冷订单落地，预计26年净利润3-3.5亿

华西有色[[看多](#)] 纳米晶电感支撑VPD+TLVR架构，解决AI算力最大瓶颈

招商电新[[看多](#)] 配储成趋势，中压UPS有望在数据中心迎来规模应用

HF电新[[看多](#)] 国瓷材料是MLCC链条上最关键的环节之一

华强北价格[[看多](#)] 三星106MQ等高端料号价格持续上涨

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择（风冷vs液冷vs金刚石材料）、订单兑现节奏以及成本控制能力

后续验证: 液冷订单落地 金刚石材料价格 散热方案渗透率 芯片功耗实际水平

关联: 思泉新材 · 飞龙股份 · 龙磁科技 · Fluence · 惠丰钻石 · 四方达 · 沃尔德 · 中天火箭

## AI数据中心供电与储能 ★★★★★☆ 2026-06-02 08:54

AI数据中心供电需求激增，储能系统从幕后走向台前，供电架构面临重塑。关键数据显示：西门子、英伟达、Fluence联合推出DSX Vera Rubin NVL72 AI数据中心参考架构，总容量136MW，IT负载100MW；Fluence Smartstack储能系统具备电压频率穿越、黑启动等功能。各家公司观点存在分歧：看好方认为储能成为AI数据中心核心基础设施；担忧方强调储能主要应对分钟至小时级别断电，与柴发不构成替代关系。相比此前，AI数据中心对供电稳定性和灵活性要求显著提升。后续验证变量包括：储能系统订单、供电架构升级情况、数据中心用电量、HVDC应用进展。

- 西门子AI数据中心供电架构总功率136MW，IT负载100MW
- NextEra以670亿美元收购Dominion Energy锁定供电权
- Fluence参与英伟达西门子合作
- HVDC单W价值量增长2.5倍

中信建投电新[[看多](#)] AIDC配储从幕后走到台前，储能系统首次纳入供电架构

东吴汽车[[看多](#)] 电力为AI底层基建，重要性将持续提升

Fluence[[看多](#)] AI工厂基础设施方案包含储能标准架构

兴证金属[[看多](#)] AI供电升级打开芯片电感百亿空间

开源电新[[看多](#)] 电源价值量通胀为指数级非线性增长

△ 分歧: 主要差异在储能配置比例、不同地区政策要求以及储能商业模式的经济性验证

后续验证: 储能系统订单 供电架构升级情况 数据中心用电量 HVDC应用进展

关联: Fluence · 潍柴动力 · 海伦哲 · 江海股份 · 杰华特 · 芯朋微

光通信 (2条)

## AI光互联/CPO产业链 ★★★★★ 2026-06-02 08:54 ~ 2026-06-03 00:10

CPO和NPO技术进入实质性量产阶段，光互联需求呈现爆发式增长态势。关键数据显示：英伟达Spectrum-X CPO交换机已全面量产，预计明年10万台+，后年50-80万台出货；1.6T硅光批量出货，三波段光缆带宽扩容5倍。各家观点分化：看好方认为天孚通信在NV CPO供应链中地位稳固，份额占比较高；分歧在于兑现节奏，部分认为2027年仍有争议，但2028年50万台+基本一致预期。相比此前，CPO从概念阶段转向实际量产部署阶段。后续验证变量包括：CPO出货量、NPO订单落地、硅光芯片产能、光模块价格走势。

- 英伟达Spectrum-X CPO交换机全面量产
- 天孚通信在NV供应链核心地位凸显
- S+C+L三波段光缆带宽扩容5倍
- CPO一致预期上调至30万台

天孚通信[[看多](#)] CPO全面量产，天孚在NV供应链核心地位极其凸显  
国联民生电子[[看多](#)] 剑桥科技Q1业绩大增，芯片紧缺物料储备充分  
国盛通信[[看多](#)] 全球首条三波段光缆商用落地，光模块需求爆发  
HF电新[[看多](#)] 国瓷材料是MLCC链条上最关键的环节之一  
华强北价格[[看多](#)] 三星106MQ等高端料号价格持续上涨

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择时机、各公司产品化进度以及估值水平和订单验证节奏

后续验证: CPO出货量 NPO订单落地 硅光芯片产能 光模块价格走势

关联: 天孚通信 · 剑桥科技 · 光库科技 · 中际旭创 · 新易盛 · 源杰科技 · 立讯精密 · 长芯博创 · 联特科技 · 东山精密

## 光芯片与光模块供应链 ★★★★★☆ 2026-06-02 08:54

AI光互联需求爆发推动光芯片产能规划大幅上调，供应链逐步改善但仍存在紧张。关键数据显示：1.6T硅光批量出货，北美数据中心需求景气，光纤光缆需求增长；剑桥科技Q1营收13亿同比增长44%，净利润1.18亿元同比增长276%。各家观点一致看好需求增长，分歧在于产能扩张速度和物料短缺缓解程度：部分认为物料储备充分，芯片紧缺状况改善；另一部分关注光芯片产能爬坡周期。相比此前，光模块供应链从紧张转向逐步平衡。后续验证变量包括：光芯片产能利用率、光模块出货量、物料短缺情况、客户订单增长。

- 东山精密光芯片产能规划大幅上调
- 新易盛1.6T硅光已批量出货
- 联特科技获核心光芯片供应保障
- 亨通光电涨停

东山精密[[看多](#)] 光芯片需求将随柜内光互联趋势爆发，2027-29年客户指引年增100%  
联特科技[[看多](#)] 物料保障充足，北美客户突破打开翻倍空间  
新易盛[[看多](#)] 物料短缺问题逐季改善，明年1.6T需求大增  
天风通信[[看多](#)] 北美数据中心需求景气国内厂商有望持续突破  
烽火通信[[看多](#)] 数据中心光纤需求拉动A1涨价继续

△ 分歧: 主要差异在不同技术路线竞争格局、各公司客户获取能力以及供应链瓶颈缓解时间

后续验证: 光芯片产能利用率 光模块出货量 物料短缺情况 客户订单增长

关联: 东山精密 · 联特科技 · 新易盛 · 天孚通信 · 亨通光电 · 长飞 · 杭电 · 中天 · 烽火 · 特发

## 机器人 (1条)

### 人形机器人产业化 ★★★★★☆ 2026-06-02 22:55

人形机器人产业化进程加速，Optimus量产渐行渐近成为重要催化剂。核心结论是人形机器人作为物理AI载体趋势明确。关键数据显示：国产机器人公司IPO持续推进，产业生态逐步完善。各家观点基本一致看好长期前景，分歧在于量产时间节点和成本下降速度：部分认为2026-2027年有望实现规模化量产；另一部分关注技术成熟度和市场需求匹配度。相比此前，产业化从概念验证转向实际生产阶段。后续验证变量包括：Optimus量产进度、机器人订单情况、成本下降幅度、应用场景拓展。

- Optimus量产渐行渐近
- 国产机器人公司IPO持续推进
- 机器人是AI应用重要方向

机械周观点[[看多](#)] 人形机器人是AI应用重要方向，Optimus量产渐行渐近  
机器人板块[[看多](#)] 国产机器人公司IPO持续推进，板块波动聚焦优质环节

△ 分歧: 主要差异在量产时间节点、成本控制能力以及市场需求规模

后续验证: Optimus量产进度 机器人订单情况 成本下降幅度 应用场景拓展

关联: 优必选 · 兆威机电 · 鸣志电器 · 雷赛智能

## 军工 (1条)

## 商业航天产业化 ★★★☆☆ 2026-06-02 20:49

SpaceX上市催化商业航天产业化，千帆星座加速组网推动卫星制造需求。关键数据显示：SpaceX将于6月12日上市，募资750亿美元估值2万亿美元；千帆星座组网加速，卫星批量交付需求提升。各家公司观点一致看好产业化进程，分歧在于订单转化速度和盈利模式：部分认为卫星AIT总装能力稀缺，订单可见度高；另一部分关注航天项目周期长、回款风险。相比此前，商业航天从试验阶段转向规模化应用。后续验证变量包括：卫星订单落地、航天项目进度、产业化收入确认、政策支持力度。

- SpaceX将于6月12日上市估值2万亿美元
- 千帆星座组网加速
- 朱雀三号运载火箭运抵酒泉

上海沪工[[看多](#)] SpaceX上市催化+千帆星座加速，卫星制造配套核心受益

星河动力[[看多](#)] 智神星一号主动力系统完成回收测试

蓝箭航天[[看多](#)] 朱雀三号可回收火箭已运抵酒泉

△ 分歧: 主要差异在产业化进度、技术成熟度以及下游订单稳定性

后续验证: 卫星订单落地 航天项目进度 产业化收入确认 政策支持力度

关联: 上海沪工 · 航天发展 · 中国卫星 · 航天电子

## 新能源 (1条)

### 户储需求景气度验证 ★★★☆☆ 2026-06-02 09:32

Q2户储排产持续上行，海外需求进一步验证，新兴市场贡献弹性。关键数据显示：澳洲补贴带动抢装，欧洲需求逐步恢复，中东等新兴市场增长贡献。各家公司观点一致看好需求景气，分歧在于增长可持续性和竞争格局：部分认为需求增长具有长期可见度；另一部分关注政策变化和价格竞争压力。相比此前，户储市场从政策驱动转向市场化需求。后续验证变量包括：Q2排产量、海外订单情况、价格走势、政策变化。

- 德业、艾罗、固德威Q2订单及排产维持高位
- 澳洲14kWh以下机型补贴延续
- 海伦哲储能消防26年营收约6亿元

华安电新[[看多](#)] Q2排产持续上行，海外户储景气度进一步验证

锦浪科技[[看多](#)] 户储逆变器3月起需求持续旺盛，4月出货近10万台

海伦哲[[看多](#)] 海外市占率50%+，26年Q2营收显著好于Q1

△ 分歧: 主要差异在不同区域需求持续性和政策变化影响，以及国内户储市场启动时间

后续验证: Q2排产量 海外订单情况 价格走势 政策变化

关联: 德业股份 · 艾罗能源 · 固德威 · 锦浪科技 · 海伦哲

## 电子 (4条)

### AI电子元件与材料升级 ★★★★★ 2026-06-02 12:25 ~ 2026-06-03 00:09

AI服务器驱动MLCC、电容等电子元件结构性升级，高端产品价格弹性显著。关键数据显示：NVL72单机柜消耗44万颗MLCC，4月村田对AI服务器高容MLCC涨价25%-35%，三星电机跟进10%-20%；陶瓷材料在全球MLCC介质粉市占率约30%，国内市占率达80%。各家公司观点一致看好高端化趋势，分歧在于价格传导幅度和订单兑现速度：部分认为终端对价格不敏感，定价权在原厂；另一部分关注成本传导压力。相比此前，AI专用元件标准化程度提升。后续验证变量包括：MLCC价格走势、高端产品订单量、材料价格传导情况、库存周转率。

- NVL72单机柜消耗44万颗MLCC
- 4月村田对AI服务器高容MLCC涨价25%-35%
- 三星电机跟进10%-20%
- AI服务器MLCC用量大幅提升

HF电新[[看多](#)] 陶瓷材料是MLCC链条上最关键的环节之一

华强北价格[[看多](#)] 三星106MQ等高端料号价格持续上涨

国瓷材料[[看多](#)] 本轮MLCC周期是AI服务器驱动的结构性升级

建投海外[[看多](#)] 腾讯微信AI助手催化释放，重估逻辑正在兑现

腾讯控股[[看多](#)] 微信正从社交入口向AI任务中心升级

△ 分歧: 主要差异在涨价持续性、技术路线选择 (PTFE vs 玻纤)、不同公司的技术壁垒以及订单兑现节奏

后续验证: MLCC价格走势 高端产品订单量 材料价格传导情况 库存周转率

关联: 国瓷材料 · 三环集团 · 风华高科 · 鸿远电子 · 火炬电子 · 厦门钨业 · 联瑞新材 · 圣泉集团 · 东材科技 · 中船特气 · 捷捷微电 · 芯联集成 · 华润微 · 士兰微 · 新洁能 · 扬杰科技 · 振华科技 · 江丰电子

## PCB与高端材料升级 ★★★★★ 2026-06-02 08:51

Rubin架构推动PCB从被动载体向主动介质转变，高端CCL材料需求激增。关键数据显示：Rubin架构引入78层正交背板，M8-M9材料体系大幅升级，未来有望升级至M10材料体系；PCB在AI机架中角色发生根本迁移，部分原本属于铜缆、连接器的价值转移到PCB。各家观点存在技术路线分歧：看好方认为PCB半导体化趋势明确；担忧方关注材料技术壁垒和成本控制。相比此前，PCB价值量显著提升且技术要求更加严格。后续验证变量包括：M9-M10材料出货量、PCB层数提升情况、正交背板订单、材料价格变化。

- Rubin架构PCB角色发生根本迁移
- M8-M9材料体系大幅升级
- PCB半导体化趋势明显
- 电子布价格上涨0.7元/米至7.2-7.5元/米

**PCB材料**[\[看多\]](#) Rubin架构引导PCB价值重估，CCL材料体系升级

**PCB钻针**[\[看多\]](#) 正交背板方案测试通过，PCB层数影响钻针量价

**PTFE影响**[\[中性\]](#) PTFE对玻纤影响有限，主流仍以混压结构为主

**消费电子光学**[\[看多\]](#) A客户使用3D玻璃，增加加热成型、抛磨设备需求

**宇晶股份**[\[看多\]](#) A客户3D玻璃设备有望正式下单，交易性机会出现

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择 (PTFE vs 玻纤 vs 3D玻璃方案)、升级节奏以及不同公司的技术壁垒差异

后续验证: M9-M10材料出货量 PCB层数提升情况 正交背板订单 材料价格变化

关联: 生益科技 · 华正新材 · 联瑞新材 · 金银河 · 国际复材 · 中材科技 · 宏和科技 · 锡业股份 · 宇晶股份 · 美迪凯 · 宇环数控 · 西克

## 半导体设备与材料需求 ★★★★★ 2026-06-02 08:52

AI和存储需求推动半导体设备需求爆发，先进制程扩产加速。关键数据显示：铠侠未来三年年均capex约4700亿日元，较2025年增长约60%；研发投入年均2300亿日元，增长60%；2028年前NAND市场CAGR略超20%。各家观点一致看好设备需求，分歧在于先进封装技术渗透速度：部分认为CoWoS、3D封装需求增长迅速；另一部分关注技术成熟度和成本控制。相比此前，AI专用芯片对设备要求更加严格。后续验证变量包括：设备订单情况、先进封装产能、材料需求增长、Capex投入进度。

- MLCC高标号产品100%强检
- 1亿颗高端电容产线配置500-1000万老化设备
- 中芯国际、华虹半导体扩产加速
- 通富微电是AMD核心供应商占80%以上业务

**中金半导体**[\[看多\]](#) 国产先进制程晶圆厂扩产加速，AI计算电源芯片需求大幅增长

**杭可科技**[\[看多\]](#) AI相关环节老化测试从抽检走向强检，设备市场将爆发

**芯基微装**[\[看多\]](#) mSAP工艺带动载板设备超预期，今年60-70台订单

**国联民生电子**[\[看多\]](#) 通富微电是AMD核心封测供应商，算力业务驱动业绩突破

**中金科技硬件**[\[看多\]](#) 铠侠资本开支大幅增长，重点投向新存储架构

△ 分歧: 主要差异在不同设备类型需求增长速度和国产化替代进程，以及AI对各类半导体材料需求弹性

后续验证: 设备订单情况 先进封装产能 材料需求增长 Capex投入进度

关联: 中芯国际 · 华虹半导体 · 杭可科技 · 芯基微装 · 通富微电 · 中船特气 · 铠侠 · 华峰测控

## 量子计算产业化 ★★★★★ 2026-06-02 23:19

IBM承诺投资超100亿美元，英伟达推出NVQLink，量子计算进入产业化加速期。关键数据显示：IBM目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机；十五五未来产业中量子排首位。各家观点存在较大分歧：看好方认为量子计算产业化高度确定；担忧方强调技术发展不及预期、商业化落地低于预期等风险。相比此前，量子计算从实验室阶段转向产业化布局。后续验证变量包括：技术突破进展、商业化应用案例、投资落地情况、企业IPO进程。

- IBM承诺投资超100亿美元
- 目标2029年实现大规模容错量子计算机
- 十五五量子排首位

**东北电子**[\[看多\]](#) 量子计算落地高度确定性，IBM投资超100亿美元

**量子板块**[\[看多\]](#) 一级市场多家量子企业融资一路绿灯，国仪量子IPO加速

△ 分歧: 主要差异在商业化落地时间表、技术成熟度以及市场需求验证

后续验证: 技术突破进展 商业化应用案例 投资落地情况 企业IPO进程

关联: 国盾量子 · 国仪量子 · 频准激光

其他 (1条)

## 造船行业复苏 ★★★☆☆ 2026-06-02 11:43

新船造价持续走高，油轮订单旺盛，散货船订单后续增长可期。关键数据显示：油轮订单表现强劲，散货船订单后续有大幅增长可能。各家公司观点一致看好行业上行趋势，分歧在于复苏持续性和细分市场表现：部分认为造船行业进入新一轮景气周期；另一部分关注全球经济环境和航运需求变化。相比此前，造船行业从低迷转向复苏阶段。后续验证变量包括：新船订单量、造船价格走势、交付进度、航运需求变化。

- 克拉克森周度新船造价指数185.02点
- 2026年1-5月全球船舶行业新接订单同比增长128%
- 位于历史峰值96.57%分位

浙商机械[看多] 新船造价持续走高，2026年有望量价齐升

中信机械[看多] 新船价格持续上涨，基本面无任何变化

△ 分歧: 主要差异在复苏持续性和订单转化速度，部分机构认为当前主要是价格驱动

后续验证: 新船订单量 造船价格走势 交付进度 航运需求变化

关联: 松发股份 · 中国船舶 · 中国动力

## 个股深度

本日无个股类内容

## 核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
<b>AI算力</b>			
德科立	688205	292.58	+8.81%
中际旭创	300308	1017.99	+8.28%
寒武纪	688256	1277.87	+6.49%
新易盛	300502	592.52	+5.11%
福晶科技	002222	113.36	+4.30%
茂莱光学	688502	561.00	+3.92%
天孚通信	300394	342.45	+3.17%
润建股份	002929	79.80	+2.77%
生益科技	600183	85.62	+2.34%
芯原股份	688521	271.99	+1.72%
欧陆通	300870	394.40	+1.52%
仕佳光子	688313	180.97	+1.33%
麦格米特	002851	125.33	+0.26%
浪潮信息	000977	73.13	-
蔚蓝锂芯	002245	22.81	-
光迅科技	002281	201.50	-
沪电股份	002463	108.68	+0.00%
联特科技	301205	281.50	-
烽火通信	600498	59.01	-
海光信息	688041	349.19	-
炬光科技	688167	475.00	-
源杰科技	688498	1731.00	-
胜宏科技	300476	375.43	-0.74%
深南电路	002916	329.79	-1.12%
太辰光	300570	176.71	-1.17%
<b>AI应用</b>			
宇信科技	300674	19.03	-
科大讯飞	002230	48.83	-2.92%
金山办公	688111	261.50	-4.18%
<b>机器人</b>			
绿的谐波	688017	273.87	+1.06%
拓普集团	601689	67.05	+0.13%
三花智控	002050	50.92	-
鸣志电器	603728	63.43	-0.75%
恒立液压	601100	112.50	-1.12%
汇川技术	300124	75.45	-2.63%
<b>光伏</b>			

帝尔激光	300776	118.35	-
福斯特	603806	18.88	-1.72%
钧达股份	002865	103.92	-2.13%
阳光电源	300274	139.85	-2.44%
迈为股份	300751	275.80	-3.53%
<b>锂电</b>			
富临精工	300432	27.49	+2.77%
湖南裕能	301358	100.66	+2.35%
德福科技	301511	93.88	-
宁德时代	300750	431.25	-3.33%
<b>军工</b>			
菲利华	300395	148.16	+12.71%
中航沈飞	600760	49.91	+1.09%
航天电器	002025	74.90	-1.91%
火炬电子	603678	33.73	-2.35%
航天电子	600879	26.02	-2.84%
<b>电子</b>			
立讯精密	002475	77.19	+1.49%
东山精密	002384	219.46	+0.53%
华勤技术	603296	109.63	-4.55%
<b>材料</b>			
石英股份	603688	73.26	+10.00%
禾盛新材	002290	90.01	-
东阳光	600673	37.45	-4.02%

内容来自知识星球「每日调研」公开信息整合，仅供研究参考，不构成投资建议。